

无卤素型聚酯覆铜箔层压板(LPET)

产品特点

- 符合 RoHS 标准, 不含卤素。
- 粘结强度高, 耐化学性好。
- 良好的尺寸稳定性。

应用领域

- 数字通讯、航空航天、计算机、汽车电子及办公自动化。

产品性能一览表

测试性能	测试方法	典型产品 LPET1ED18/S	
		性能指标	典型测试值
剥离强度 常态下	IPC-TM-650-2.4.9 方法 B	≥0.8 kgf/cm	1.70 kgf/cm
挠曲性能	IPC-TM-650-2.4.3	铜向内: ≥4000 次 铜向外: ≥2000 次	铜向内: 9000 次 铜向外: 4300 次
尺寸稳定性 腐蚀后	IPC-TM-650-2.2.4 方法 B	MD/TD: ±0.20%	MD -0.12%, TD +0.08%
浸焊性	IPC-TM-650-2.4.13	204+5/-0℃浸焊 10S 不分层不起泡	204+5/-0℃浸焊 10S 不分层不起泡
介电常数(1MHz)	IPC-TM-650-2.5.5.3	≤3.5	3.3
介质损耗因数(1MHz)	IPC-TM-650-2.5.5.3	≤0.035	0.034
体积电阻率	IPC-TM-650-2.5.17	≥10 ⁶ 兆欧·厘米	7.0 x10 ⁸ 兆欧·厘米
表面电阻	IPC-TM-650-2.5.17	≥10 ⁴ 兆欧	8.0 x10 ⁵ 兆欧
介电强度	ASTM-D-149	≥1.18 x10 ⁶ 伏/厘米	3.30 x10 ⁶ 伏/厘米
绝缘电阻	IPC-TM-650-2.6.3.2	10 ⁵ 兆欧	9.0 x10 ⁶ 兆欧
湿态下绝缘电阻	IPC-TM-650-2.6.3.2	10 ⁴ 兆欧	8.0 x10 ⁶ 兆欧

注: 以上数据为典型产品的典型数值, 最终出货产品具体数据以对应批次的测试报告为准; 这些数据供客户应用时参考, 产品是否适合其相关使用应由客户最终判定。

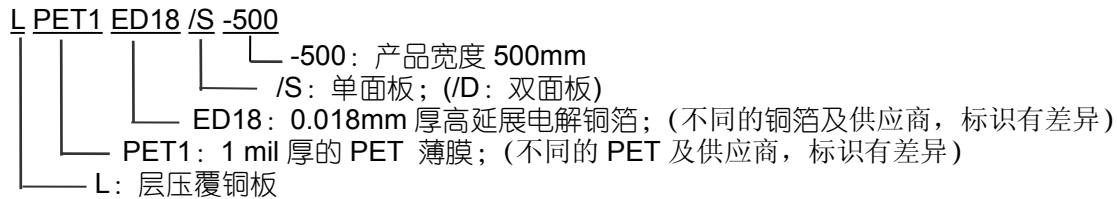
产品说明书

发布日期: 2015年5月

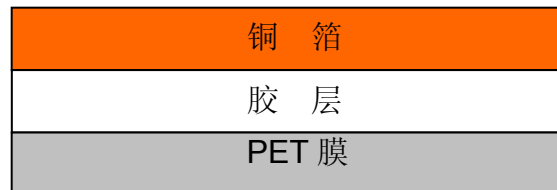
无卤素型聚酯覆铜箔层压板(LPET)

产品结构及代码

- 产品代码主要依据所选用的 PET 薄膜和铜箔不同规格来区分, 例如:



- 产品结构示意图(单面)



主要产品结构及代码表

产品代码	材 料 厚 度			铜箔类型	单/双面板
	PET 膜厚 (mil)	胶粘剂厚 (um)	铜箔厚 (um)		
	0.5、1、2、3 等	12、21 等	12、18、35 等		
LPET0.5ED18/S(D)	0.5	12	18	电解铜箔	单(双)
LPET1ED18/S(D)	1	21	18	电解铜箔	单(双)
LPET1RA18/S(D)	1	21	18	压延铜箔	单(双)
LPET1ED35/S(D)	1	21	35	电解铜箔	单(双)
LPET1RA35/S(D)	1	21	35	压延铜箔	单(双)
LPET2ED35/S(D)	2	21	35	电解铜箔	单(双)
LPET2ED18/S(D)	2	21	18	电解铜箔	单(双)
LPET3ED35/S	3	21	35	电解铜箔	单
LPET5ED35/S	5	21	35	电解铜箔	单

注: 除以上规格外, 还可以根据客户需要生产其他指定规格的产品。

标准包装

- 标准卷数量为 25 或 50 平方米。
- 标准宽为 250mm、500 mm, 宽度公差±1mm; 其它宽度可根据客户要求协商。
- 芯轴直径为 152mm(6 英寸) 或 76mm(3 英寸), 标准包装为纸箱。

储存

- 储存条件: 温度: 5~30℃, 相对湿度: ≤75%; 储存期: 自生产之日起 12 个月 (原包装未拆封)。